



/ Revised record

版本	修订日期	有修订的页码	修订涉及的内容	拟制	审核
D	2017-5				
E	2021-1-27	4/7	更新外形图 e0.5-0.7 改为 0.5-0.8 ,包装资料 5 盒改为 7 盒	黄超	刘晓荣

/ Descriptions

表面贴装肖特基桥，薄型封装。

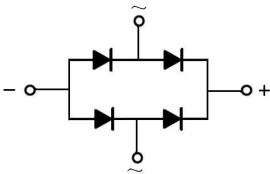
/ Features

浪涌电流大，反向电压：40V~200V，正向电流：1.0A，适用于表面贴装。无卤产品。

/ Applications

一般用途.

/ Equivalent Circuit



/ Pinning



PIN	DESCRIPTION
1	Input Pin (~)
2	Input Pin (~)
3	Output Anode (+)
4	Output Cathode (-)



/ Marking

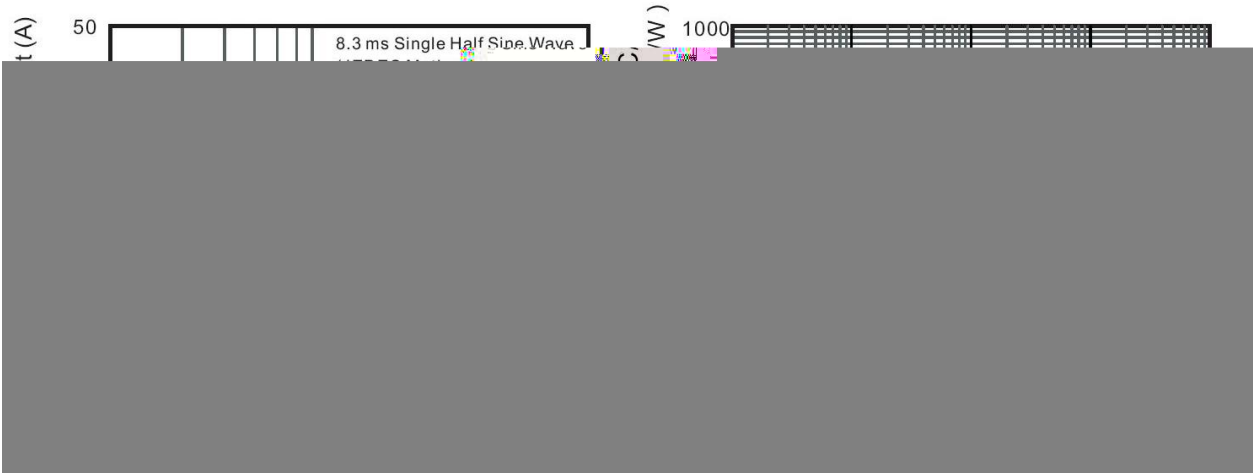
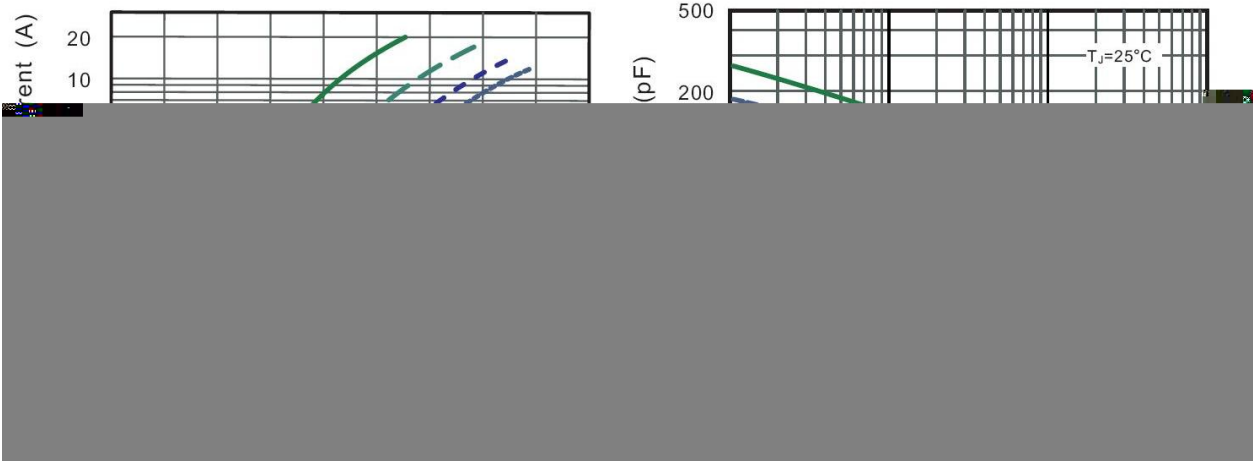
见印章说明。



参数	符号	数值	单位
----	----	----	----



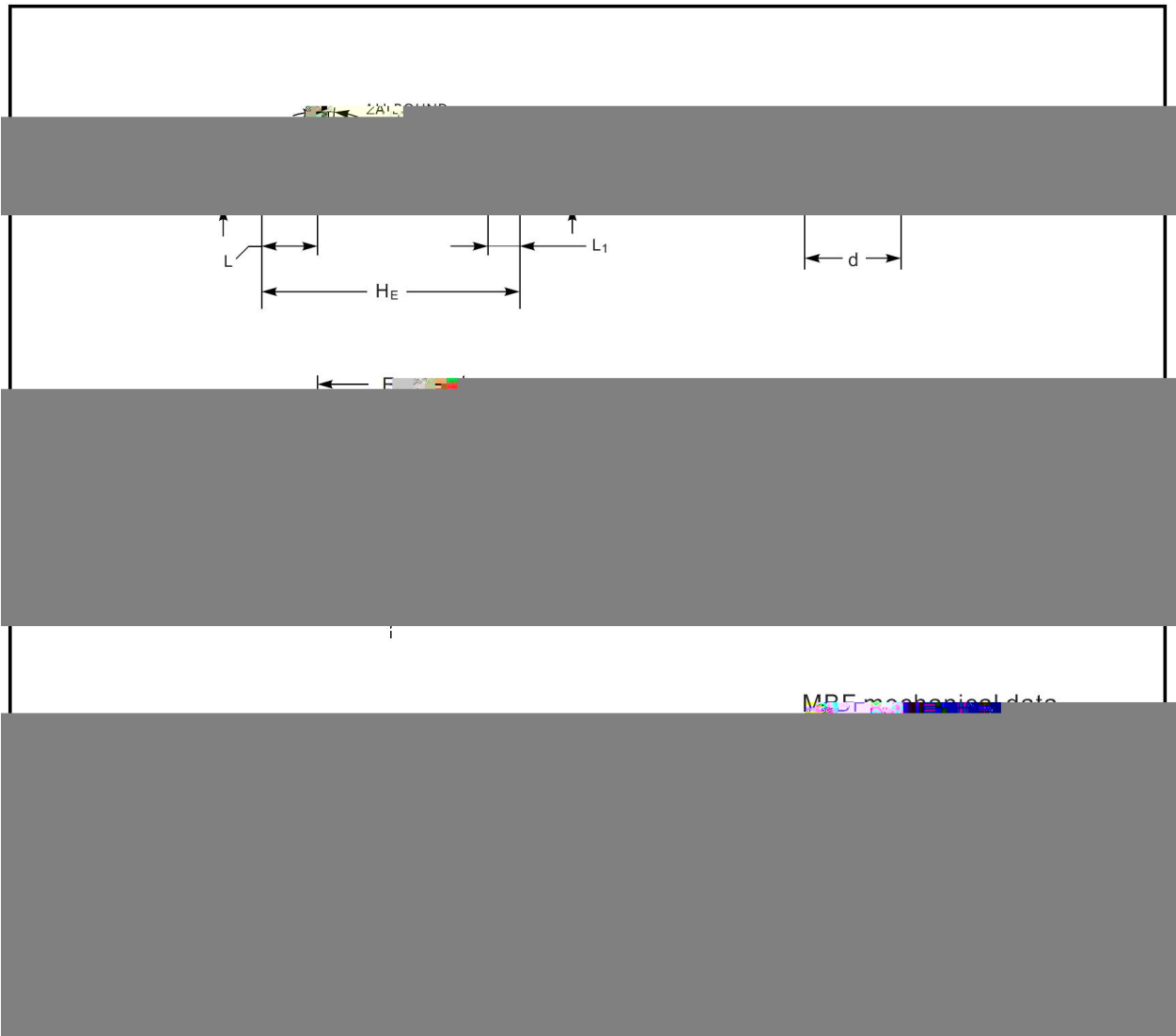
/ Electrical Characteristic Curve





/ Package Dimensions

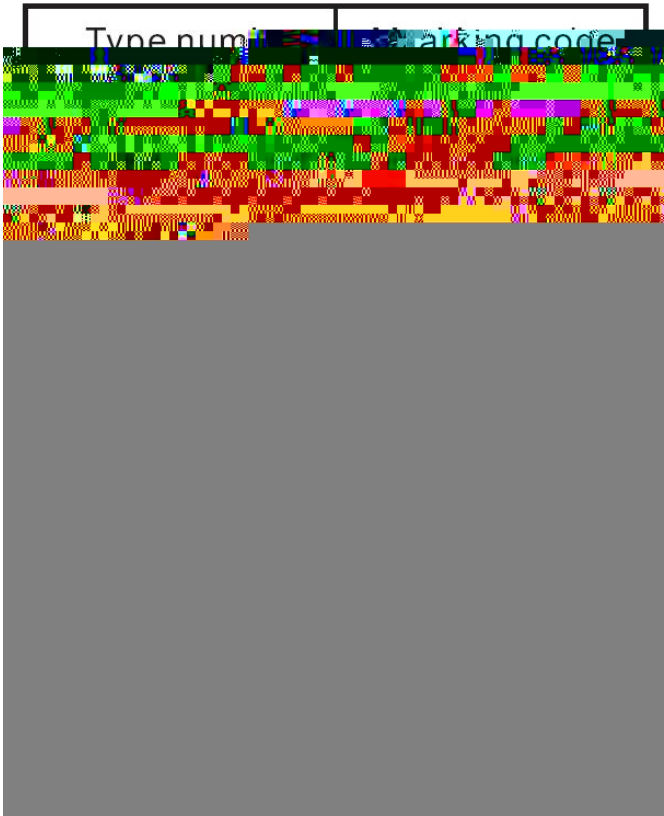
MBF



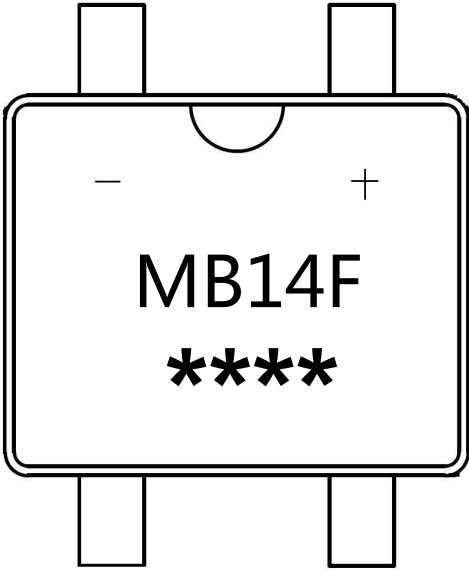


/ Marking Instructions

Marking



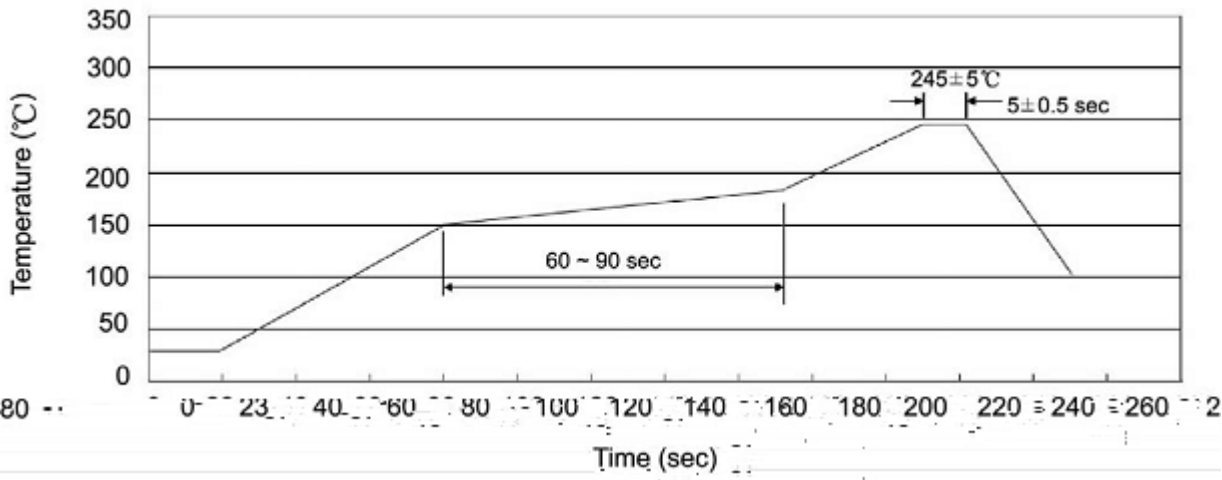
/ Marking Instructions



说明

- : 为型号代码
- : 为生产批号追溯码，第 个 为年月代码，后面 个 为当月小批号代码
- :
- :

() / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)



说明：

、预热温度 ~ °C，时间 ~ °C

、峰值温度 ± °C，时间持续为 ± °C ±

、焊接制程冷却速度为 ~ °C °C

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度： ± °C 时间： ± ± °C ±

/ Packaging SPEC.

卷盘包装

封装形式	包装数量					包装尺寸		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱